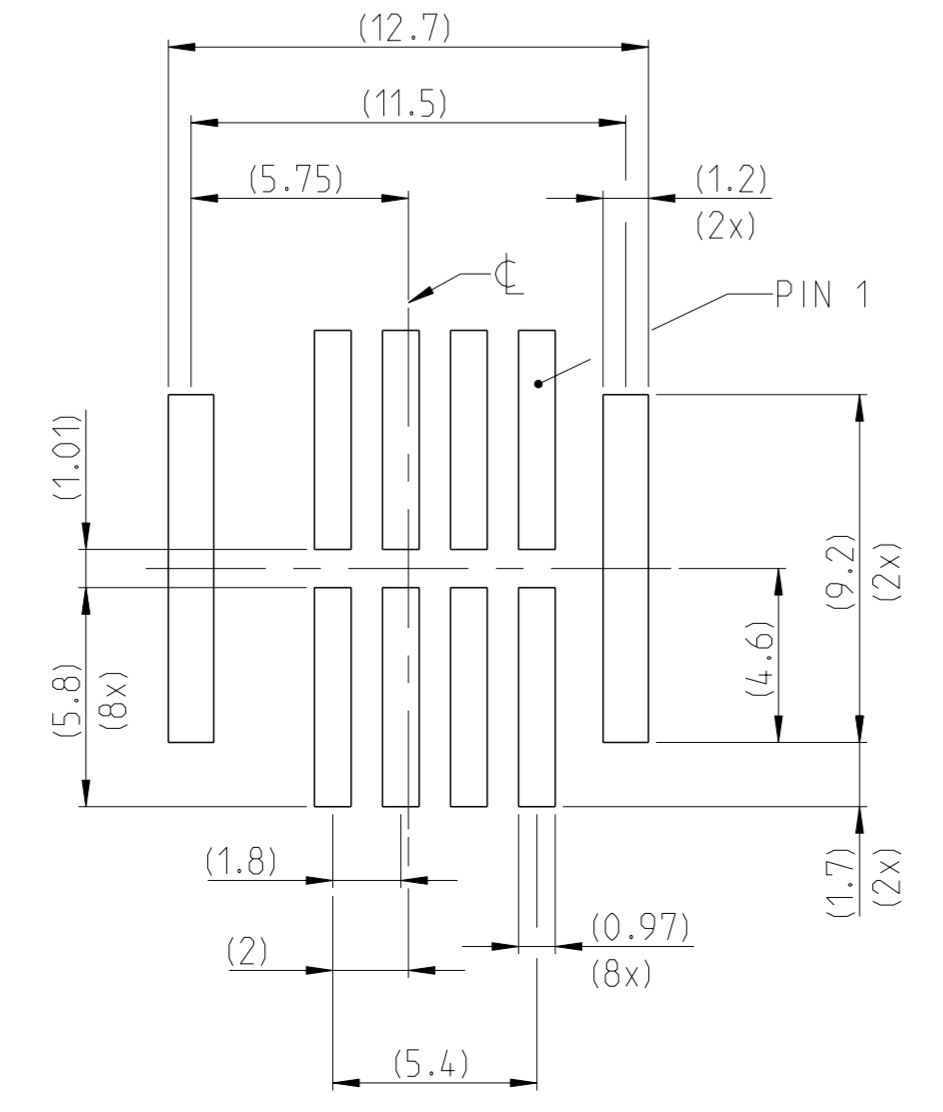
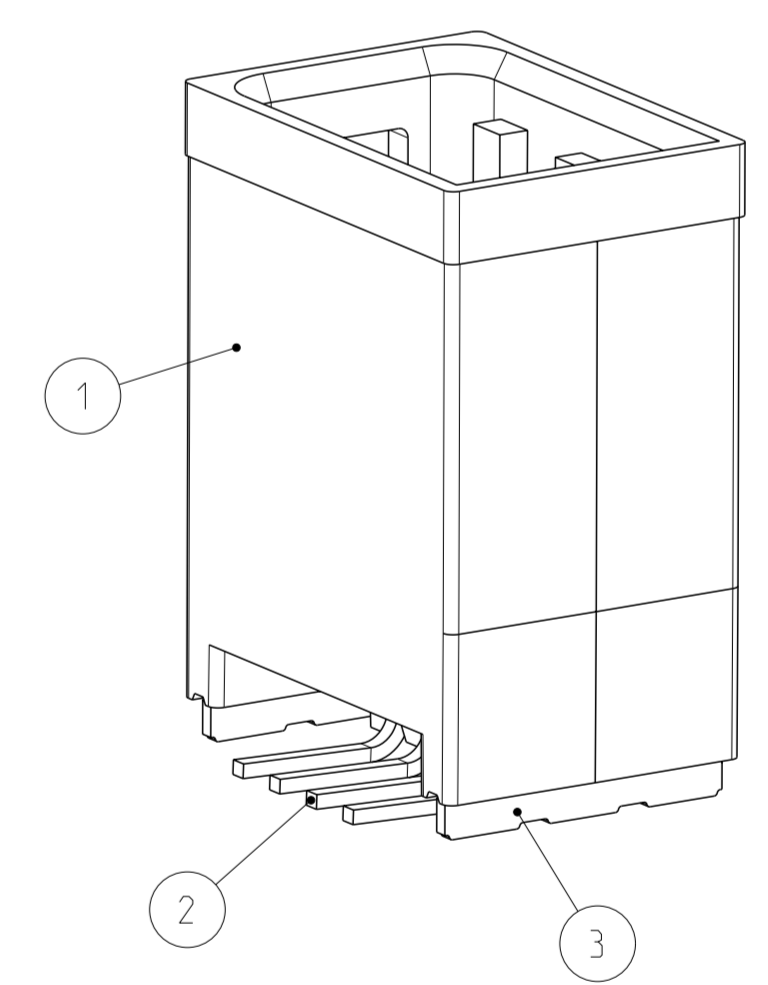


POSSIBLE PCB LAYOUT
 CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR LAYOUT
 Mögliches Leiterplattenlayout
 Kunde ist fuer Leiterplattenlayout verantwortlich



- NOTES
 Bemerkungen
- 1 PRESS OUT FORCE FOR NANOMQS CONTACT >15N WITH FEED RATE 25mm/min
 Kontaktausdruckkraft fuer NanoMQS Kontakt >15N mit Vorschubgeschwindigkeit 25mm/min
 - 2 PRESS OUT FORCE FOR SOLDER BRACKET >60N WITH FEED RATE 25mm/min
 Kontaktausdruckkraft fuer Loetblech >60N mit Vorschubgeschwindigkeit 25mm/min
 - 3 INTERFACES ACC. TO 114-94000-20. REV. A1, Version 1.
 Schnittstellen nach 114-94000-20. Rev. A1, Version 1.
 - 4 INTERFACE IS NOT PART OF PPAP. TE CONNECTIVITY IS RESPONSIBLE FOR CONNECTOR SYSTEM
 Schnittstelle ist nicht Bestandteil des PPAP. TE Connectivity ist verantwortlich fuer Stecksystem
 - 5 TOLERANCES ACC. TO DIN EN ISO 8015. DIN EN ISO 14405-1
 GENERAL TOL. ACC. TO DIN 16742 TGS. EXCEPT ANGLE DIM. (SEE TITLE BLOCK)
 Tolerierung nach DIN EN ISO 8015. DIN EN ISO 14405-1
 Allgemeintoleranzen nach DIN 16742 TGS. ausser Winkelmasse (siehe Schriftkopf)
 - 6 PACKAGING IN TAPE & REEL ACC. TO V2317523
 Verpackung in Tape & Reel nach V2317523
 - 7 SOLDER BRACKET SURFACE 3-8µm Sn OVER 1.0-2.5µm Ni
 Loetblechoberflaeche 3-8µm Sn ueber 1.0-2.5µm Ni
 - 8 CONTACT SURFACE SOLDER SIDE 3-8µm Sn OVER 1.0-2.5µm Ni. MATING SIDE Sn ACC. 114-94201
 Kontaktoberflaeche Loetseite 3-8µm Sn ueber 1.0-2.5µm Ni. Steckseitenach Sn nach 114-94201
 - 9 FOR MISSING DIMENSION SEE CAD-MODEL 2317523. REV. A
 Fehlende Masse sind dem CAD-Model 2317523. zu entnehmen. rev. A
 - 10 AREA FOR GOOD PART MARKING: WITH PUNCH MARK OR LASER MARKING
 Bereich fuer Gueteilmarkierung: Mit Koernerpunkt oder Lasermarkierung
 - 11 ELECTRICAL 100% FINAL INSPECTION FOR CONTINUITY AND SHORT CIRCUIT
 AS WELL AS EXISTENCE OF ALL CONTACTS
 Elektrische 100% Endpruefung auf Durchgang und Kurzschluss,
 sowie das Vorhandensein aller Kontakte
 - 12 REFERENCE POINTS A5.6.7.8 ARE ON OPPOSITE SITE OF A1.2.3.4
 Bezugspunkte zu A5.6.7.8 auf gegenueberliegender Seite von A1.2.3.4
 - 13 SOLDERING PROCESS: LEAD-FREE REFLOW SOLDERING IN REFERENCE TO JEDEC J-STD-020D
 Loetprozess: Bleifreies Loeten in Anlehnung an JEDEC J-STD-020D
 - 14 COLOURED IDENTIFICATION MARK FOR C-SAMPLES
 Farbliche Markierung fuer C-Muster
 - 15 PINS OPTIONAL ALLOWED, BUT AT CPA-CONNECTOR WITHOUT ELECTRIC FUNCTION
 Pins optional zulassig, aber bei CPA-Stecker ohne elektrische Funktion
 - 16 CUT OUT WITH PLAIN STAMPING EDGES
 Ausschnitt mit blanken Stanzkanten
 - 17 POSITION OF HOUSING PN, REVISION AND MATERIAL MARKING MAY DIFFER FROM SERIES TO PRE-SERIES
 Position der Gehaeuse-PN, Revision und Materialkennzeichnung abweichend von Serie zu Vorserie



SERIES							PN: 2320008 - suitable Receptacle Housing w/o CPA						
x-	-1	-2	N/A	N/A	N/A	N/A	PN: 2312106 - suitable Receptacle Housing w/ CPA						
x-	-1	-2	N/A	N/A	N/A	N/A	Solder Brackets	-	A	Copper-Alloy	-	3	
B	8	8	8	8	8	8	NanoMQS Pin	-	A	Copper-Alloy	-	2	
-	-	-	-	-	-	1	BPos Header Housing	Z	A	PA4T-GF30	waterblue	5021	1
-	-	-	-	-	-	1	BPos Header Housing	F	A	PA4T-GF30	brown	1bd	1
-	-	-	-	-	-	1	BPos Header Housing	E	A	PA4T-GF30	green	1bd	1
-	-	-	-	-	-	1	BPos Header Housing	D	A	PA4T-GF30	claret-violet	4004	1
-	-	-	-	-	-	1	BPos Header Housing	C	A	PA4T-GF30	blue	5005	1
-	1	-	-	-	-	-	BPos Header Housing	B	A	PA4T-GF30	nature	-	1
1	-	-	-	-	-	-	BPos Header Housing	A	A	PA4T-GF30	black	9011	1
							DESCRIPTION	COD.	REV.	MATERIAL	SURFACE/COLOR	RAL (similar)	POS.
A	A	A	A	A	A	A	Assy. Rev.						
							TE Part No.						
0-x-1	0-x-2	0-x-3	0-x-4	0-x-5	0-x-6	0-x-9	Theoretical Weight (gr.)						
1.47	1.47	1.45	1.46	1.47	1.47	1.42							

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DATE: 08MAR2017
 DRAWN BY: A. Jay Nair
 CHECKED BY: K. HAPR2017
 APPROVED BY: K. HAPR2017

400% Inspection
 cmk >= 1.67
 Gauge Inspection

STE logo

TE Connectivity

8Pos. NanoMQS. Header Assy.
 6Pos+CPA
 180Deg. SMD

SCALE: 5:1 SHEET 1 OF 1

0-2317523-1 AS SHOWN
 wie gezeichnet